**RTV2 电子灌封、密封胶MR2349AB**

**产品描述：**

MR2349AB有机硅导热灌封胶是一种室温/加温固化的加成型有机硅材料。这种双组分弹性硅胶设计用于灌封、保护处在严苛条件下的电子产品。

MR2349AB有机硅导热灌封胶使用了新型技术，无需加热就能很好地固化。以 1:1（重量比或体积比）彻底混和 A 组分和 B 组分后，产品在一定时间内固化，形成弹性缓冲材料。固化后的弹性体具有以下特性：

抵抗湿气、污物和其它大气组分

减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力 容易修补

高频电气性能好

无溶剂，无固化副产物

在-50-250℃间稳定的机械和电气性能优异的阻燃性

**常规性能：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 测试标准 | 单位 | A组分 | B组分 |
| 外 观 | 目 测 | --- | 黑色粘稠液体 | 白色粘稠液体 |
| 粘 度 | GB/T 10247-2008 | mPa·s（25℃） | 4500±600 | 3500±600 |
| 密 度 | GB/T 13354-92 | g/cm3（25℃） | 1.50±0.05 | 1.50±0.05 |

**操作工艺：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 单位或条件 | 数值 |
| 混合比例 | 重量比 | 100：100 |
| 混合比例 | 体积比 | 100：100 |
| 混合粘度 | mPa·s（25℃） | 4000±1000 |
| 混合密度 | g/cm3（25℃） | 1.50±0.05 |
| 操作时间（1） | min（25℃） | 55±10 |
| 固化时间 | ℃/hr | 80/0.5或25/10 |

（1）操作时间是以配胶量100g来测试的。

将 A、B 两组分按比例取出配比、搅拌混合均匀，抽真空去除气泡，在操作期内浇注到需灌封产品上，如灌封产品太大，建议分次灌封，然后根据（80℃/30min 或 25℃/10hr）固化即可。

**操作注意事项：**

·胶料放置时间过长，会产生沉淀，建议在取用前请先将 A、B 组分各自搅拌均匀，取用后应注意密封保存。

·搅拌时应注意同方向搅拌，否则会混入过多的气泡；容器边框和底部的胶料也应搅拌均匀，否则会出现由搅拌不均而引起局部不固化现象。

·浇注到产品上再次抽真空去除气泡，可提高固化后产品的综合性能。

·温度过低会导致固化速度偏慢，建议加热固化。

·MR2349AB与含锡、硫、胺等材料接触会难固化或不固化。

**典型性能：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
| 硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore A | 55±5 |
| 导热系数 | GB/T 10297-1998 | W/mK | 0.6-0.8 |
| 膨胀系数 | GB/T 20673-2006 | μm/（m，℃） | 210 |
| 吸水率 | GB/T 8810-2005 | 24h，25℃，  | 0.01-0.02 |
| 阻燃等级 | UL-94 | 3mm厚，105℃ | V-0（E315820） |
| 介电强度 | GB/T 1695-2005 | kV/mm（25℃） | >20 |
| 损耗因素 | GB/T 1693-2007 | （1MHz）(25℃) | 0.01 |
| 介电常数 | GB/T 1693-2007 | （1MHz）(25℃) | 3.3 |
| 体积电阻 | GB/T 1692-2008 | （DC500V）Ω· cm | 1.0×1015 |

注：以上所有数据都在胶 25℃、55%RH 条件下固化 7 天后测定所得。

**包装规格:**

A 组分：10kg/桶；B 组分：10kg/桶

**储存及运输:**

1. A、B 组分需避光、避热、密封保存（可作为非危险品运输及保存）；
2. 储存期 2 年（25℃）。